

SK 海力士 16 层 48GB HBM3E 将于 2025 年初送样， 渠道市场价格小幅下修

——存储芯片周度跟踪（2024.11.04-2024.11.08）

■ 核心观点

NAND: NAND 颗粒市场价格小幅波动，铠侠北上 K2 工厂 2025 年秋天投产 BiCS 8。根据 DRAMexchange，上周（1104-1108）NAND 颗粒 22 个品类现货价格环比涨跌幅区间为-2.82%至 2.82%，平均涨跌幅为-0.18%。其中 12 个料号价格持平，3 个料号价格上涨，7 个料号价格下跌。根据 CFM 闪存市场报道，铠侠 11 月 5 日宣布，其岩手县北上市的北上工厂「第 2 厂房(K2)」已全面竣工，为了预备 K2 投产，自 2024 年 11 月 11 日起，行政、技术部门将陆续搬进临近 K2 的新行政大楼，预估 K2 将在 2025 年秋天投产。

DRAM: 颗粒价格小幅下跌，威刚对全球生成式 AI 和云服务的快速增长持乐观态度。根据 DRAMexchange，上周（1104-1108）DRAM 18 个品类现货价格环比涨跌幅区间为-2.50%至 3.25%，平均涨跌幅为-0.64%。上周 3 个料号呈上涨趋势，14 个料号呈下降趋势，1 个料号价格持平。根据 CFM 闪存市场报道，威刚对全球生成式 AI 和云服务的快速增长持乐观态度，这一趋势正在推动高带宽存储器（HBM）和服务器存储产品的市场需求。短期内，威刚对存储行业的供需状况保持积极看法，预计市场将保持稳定。从长远来看，威刚预计随着电子产品搭载的存储容量的显著增加，以及对 2025 年 AI 个人电脑和 AI 智能手机领域可能出现的突破性产品的期待，2025 年存储行业有望迎来新的需求高峰。

HBM: SK 海力士 16 层 48GB HBM3E 将于 2025 年初送样。根据 CFM 闪存市场报道，SK 海力士继近期 HBM3E 12 层宣布量产后，其 16 层 48GB 样品计划于 2025 年初送样，SK 海力士计划扩大客户群，并加强与 NVIDIA 等大客户的合作。

市场端: 渠道市场价格小幅下修。上周（1104-1108）eMMC 价格环比下跌，UFS 价格环比下跌。根据 CFM 闪存市场报道，近期消费端市场供需双方虽进入新一轮谈价阶段，但因 mobile 终端客户因备有一定库存，且供应端部分资源供应溢出，市场看跌情绪加重，本周大容量嵌入式产品延续跌势再度走跌；虽部分应用领域需求有撑但 PC 市场整体疲势难改，且客户价格要求低，行业 SSD 价格温和小跌；渠道市场因近期需求相对冷清令其价格也小幅下修；另外，服务器 DDR5 需求有撑下价格调涨，而服务器 DDR4 整体需求依旧偏淡令其价格下跌。

■ 投资建议

我们持续看好受益先进算力芯片快速发展的 HBM 产业链、以存储为代表的半导体周期复苏主线。

HBM: 受益于算力芯片提振 HBM 需求，相关产业链有望迎来加速成长，建议关注赛腾股份、壹石通、联瑞新材、华海诚科等；

存储芯片: 受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI 带动 HBM、SRAM、DDR5 需求上升，产业链有望探底回升。推荐东芯股份，建议关注恒烁股份、佰维存储、江波龙、德明利、深科技等。

■ 风险提示

中美贸易摩擦加剧、下游终端需求不及预期、国产替代不及预期等。

增持(维持)

行业： 电子

日期： 2024年11月13日

分析师： 陈宇哲

E-mail: chenyzhe@yongxingsec.com

SAC 编号: S1760523050001

联系人： 林致

E-mail: linzhi@yongxingsec.com

SAC 编号: S1760123070001

号:

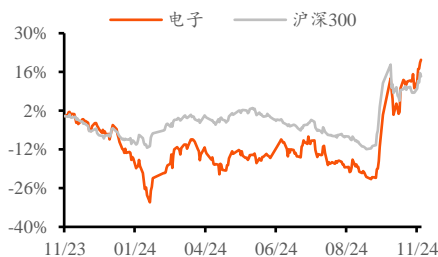
号:

号:

号:

号:

近一年行业与沪深 300 比较



资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

相关报告:

《渠道仍处于下行通道，三星持续推进 HBM4》

——2024 年 11 月 02 日

《三星电子完成 24Gb GDDR7 DRAM 开发，DRAM 中 HBM 比重逐渐提升》

——2024 年 10 月 21 日

《群联称 NAND 模组需求持续上升，DRAM 结构性分化严重》

——2024 年 10 月 15 日

正文目录

1. 存储芯片周度价格跟踪	3
2. 行业新闻	4
3. 公司动态	6
4. 公司公告	7
5. 风险提示	8

图目录

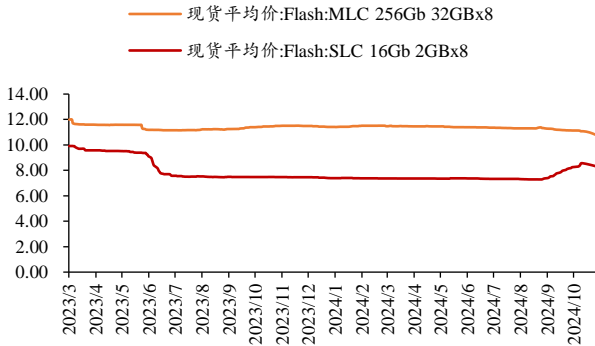
图 1: NAND 中大容量现货价格 (美元)	3
图 2: NAND 中小容量现货价格 (美元)	3
图 3: NAND Wafer 中大容量现货价格 (美元)	3
图 4: NAND Wafer 中小容量现货价格 (美元)	3
图 5: DRAM 中大容量现货价格 (美元)	3
图 6: DRAM 中小容量现货价格 (美元)	3

表目录

表 1: 存储行业本周重点公告 (11.02-11.08)	7
-------------------------------------	---

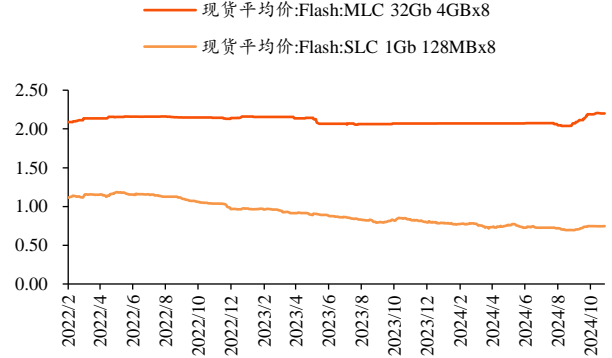
1. 存储芯片周度价格跟踪

图1:NAND 中大容量现货价格 (美元)



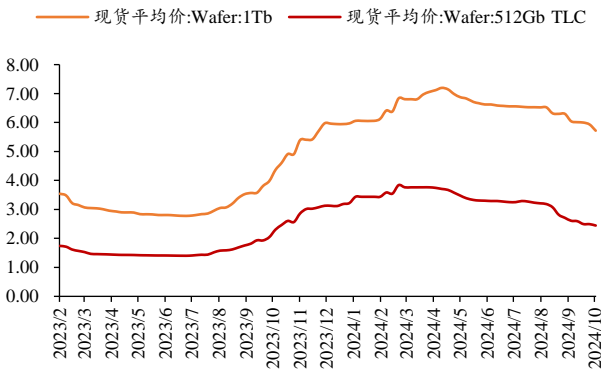
资料来源: iFind, 甬兴证券研究所

图2:NAND 中小容量现货价格 (美元)



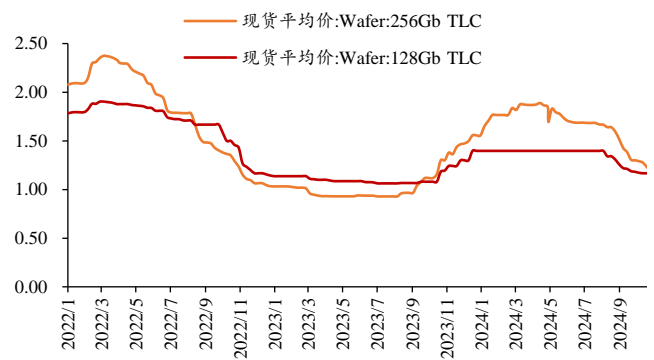
资料来源: iFind, 甬兴证券研究所

图3:NAND Wafer 中大容量现货价格 (美元)



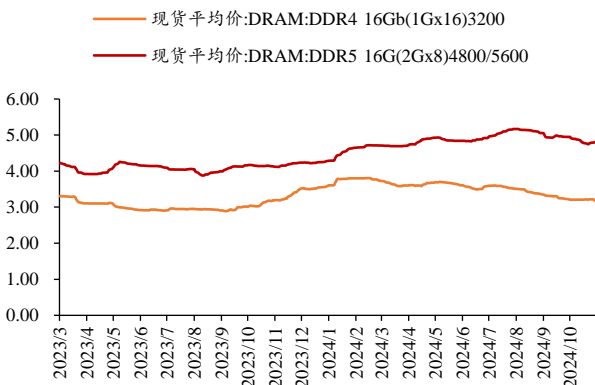
资料来源: iFind, 甬兴证券研究所

图4:NAND Wafer 中小容量现货价格 (美元)



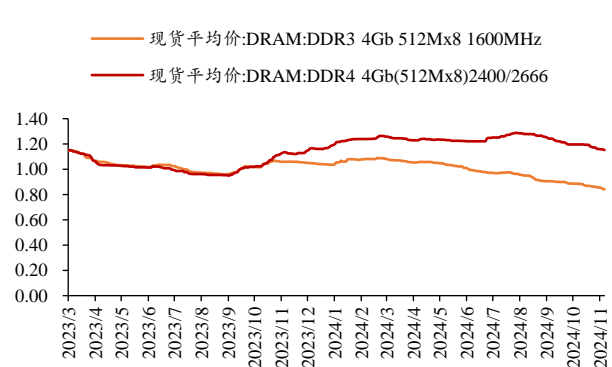
资料来源: iFind, 甬兴证券研究所

图5:DRAM 中大容量现货价格 (美元)



资料来源: iFind, 甬兴证券研究所

图6:DRAM 中小容量现货价格 (美元)



资料来源: iFind, 甬兴证券研究所

2. 行业新闻

市场看跌情绪升温，大容量嵌入式价格再度走跌，行业和渠道存储价格缓跌

11月5日消息，根据CFM闪存市场报道，近期消费端市场供需双方虽进入新一轮谈价阶段，但因mobile终端客户因备有一定库存，且供应端部分资源供应溢出，市场看跌情绪加重，本周大容量嵌入式产品延续跌势再度走跌；虽部分应用领域需求有撑但PC市场整体疲势难改，且客户价格要求低，行业SSD价格温和小跌；渠道市场因近期需求相对冷清令其价格也小幅下修；另外，服务器DDR5需求有撑下价格调涨，而服务器DDR4整体需求依旧偏淡令其价格下跌。近期，SK海力士、三星电子、西部数据等多家存储原厂相继发布三季度业绩报告，从最新数据看出，部分原厂因受三季度消费终端需求疲弱影响，加之其产品价格平均售价环比上扬，导致整体NAND和DRAM bit出货量环比较为逊色；对于供应端，部分原厂将更加注重高利润产品，减少成熟制程产品以不断完善产品组合；另外随着Windows 10支持结束、PC陆续进入更换周期，外加AI功能在智能手机不断普及，部分原厂乐观预期2025年PC和智能手机需求将逐渐复苏。

资料来源：(CFM闪存市场)

威刚：10月DRAM重回第一大产品线，前10月营收已接近2023年全年规模

11月7日消息，根据CFM闪存市场报道，在DRAM营收环比增幅近四成推升下，威刚10月合并营收达34.1亿元（新台币，下同），环比增长4.8%，同比降低10.06%；2024年前10月累计合并营收336.56亿元，同比增长27.21%，几乎已达2023年全年营收规模。预估威刚全年营收有望达400亿元，创历史次高。按产品结构来看，10月DRAM营收贡献达52.4%，重回第一大产品线（9月威刚SSD营收占比39.96%，跃居第一大产品线，DRAM占比39.5%），SSD比重34.19%，存储卡、U盘与其他产品比重为13.41%；前10月DRAM累计占整体营收比重46.08%，SSD占29.97%，存储卡、U盘与其他产品达23.95%。威刚对全球生成式AI和云服务的快速增长持乐观态度，这一趋势正在推动高带宽存储器（HBM）和服务器存储产品的市场需求。这不仅为上游供应商带来了稳定的盈利和维持存储产品价格的能力，还影响了未来的整体产能布局和投资决策。短期内，威刚对存储行业的供需状况保持积极看法，预计市场将保持稳定。从长远来看，威刚预计随着电子产品搭载的存储容量的显著增加，以及对2025年AI个人电脑和AI智能手机领域可能出现的突破性产品的期待，2025年存储行业有望迎来新的需求高峰。

资料来源：(CFM闪存市场)

SK 海力士 16 层 48GB HBM3E 将于 2025 年初送样

11 月 7 日消息，根据 CFM 闪存市场报道，SK 海力士继近期 HBM3E 12 层宣布量产后，其 16 层 48GB 样品计划于 2025 年初送样，SK 海力士计划扩大客户群，并加强与 NVIDIA 等大客户的合作。与现有的 12 层产品相比，16 层产品在 LLM（大型语言模型）学习方面的性能提高 18%，在推理方面的性能提高 32%。SK 海力士第三季度财报显示，HBM 在 SK 海力士 DRAM 总销售额中的占比从第二季度的 20% 迅速增长到第三季度的 30%，预计第四季度将达到接近 40%。该季度 HBM3E 出货量已超过 HBM3，第四季度 12 层 HBM3E 已按计划开始出货，预计 2025 年第一季度 12 层 HBM3E 将占 HBM3E 总出货量的一半以上。据介绍，16 层 48GB HBM3E 在封装方面采用 Advanced MR-MUF，该技术已在 12 层产品中证明了批量生产的能力，与此同时，SK 海力士也在开发混合键合技术作为备用工艺。SK 海力士目标是在 2025 年下半年向客户供应 HBM4 芯片，并计划在 2028 年至 2030 年期间推出 HBM5 芯片。有报道称，英伟达 CEO 黄仁勋曾要求 SK 海力士“提前六个月”供应 HBM4 芯片，这一时间比最初的目标更早。

资料来源：(CFM 闪存市场)

NAND Flash 再增新产能，铠侠北上 K2 工厂 2025 年秋天投产 BiCS 8

11 月 6 日消息，根据 CFM 闪存市场报道，铠侠 11 月 5 日宣布，其岩手县北上市的北上工厂「第 2 厂房(K2)」已全面竣工，为了预备 K2 投产，自 2024 年 11 月 11 日起，行政、技术部门将陆续搬进临近 K2 的新行政大楼，预估 K2 将在 2025 年秋天投产。生产最初计划于 2023 年进行，但由于整个行业对存储的需求下降，投产时间推迟了一年半左右。K2 工厂将量产其最先进的第 8 代 NAND Flash「BiCS8」产品，铠侠表示，受惠于 AI 热潮，预估 NAND 需求将在 2025 年以后稳健成长、像 BiCS8 这样高性能的存储需求将增加，未来五年闪存需求将增长约 2.7 倍。此外，关于是否进一步扩增产能，铠侠透露，在调查所有可能性和市场需求后、扩大产能规模。已在北上工厂南侧备有空地，会在适当的时间点进行投资。关于 IPO 的时间和进度，铠侠表示，计划在评估市场动向后、再做出决定，现阶段没有可报告的事宜。就目前的业绩来看当前并无资金上的风险。

资料来源：(CFM 闪存市场)

3. 公司动态

【深科技】公司核心竞争力包括柔性化生产制造平台，完善的生产管理体系等

11月4日，深科技在投资者互动平台表示，公司核心竞争力包括柔性化的生产制造平台，完善的生产管理体系，数字技术与制造系统的深度融合打造快速响应能力，先进的研发设计能力，强大的工程技术能力，满足客户全方位需求的平台能力，客户至上、业务驱动的流程管理体系，精益生产管理提升市场竞争力，国际化经营管理团队，重视各梯队人才培养，前瞻性的跨区域战略部署，丰富的全球优质客户资源，秉承低碳未来理念，推行绿色制造，坚持可持续发展等。

资料来源：（投资者互动平台）

【赛腾股份】日本新购买厂房正在装修中，投产后主要用于日本现有产能的扩张

11月8日，赛腾股份在投资者互动平台表示，公司与sk集团一直有业务合作，日本新购买厂房正在装修中，投产后主要用于日本现有产能的扩张，不局限于哪几种产品。

资料来源：（投资者互动平台）

4. 公司公告

表1: 存储行业本周重点公告 (11.02-11.08)

日期	公司	公告类型	要闻
2024/11/05	兆易创新	股份回购进展	截至 2024 年 10 月 31 日, 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 973,200 股, 占公司总股本的比例为 0.1462%, 购买的最高价格为人民币 89.6 元/股, 最低价格为人民币 75.79 元/股, 已支付的总金额为人民币 80,394,888 元 (不含交易费用)。
2024/11/07	佰维存储	公司为他人提供担保	本次公司为全资子公司泰来科技提供担保的金额为 2 亿元人民币。截至本公告披露日, 公司已实际为泰来科技提供的担保余额为 11 亿元人民币 (不含本次担保)。

资料来源: iFind, 甬兴证券研究所

5. 风险提示

1) 中美贸易摩擦加剧的风险

未来若中美摩擦加剧，则存在部分公司的经营受到较大影响的风险。

2) 下游终端需求不及预期的风险

未来若下游终端需求不及预期，则存在产业链相关公司业绩发生较大波动的风险。

3) 国产替代不及预期的风险

未来若国产替代不及预期，则存在国内企业的业绩面临承压的风险。

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉尽责的职业态度，专业审慎的研究方法，独立、客观地出具本报告，保证报告采用的信息均来自合规渠道，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本报告所发表的任何观点均清晰、准确、如实地反映了研究人员的观点和结论，并不受任何第三方的授意或影响。此外，所有研究人员薪酬的任何部分不曾、不与、也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

公司业务资格说明

甬兴证券有限公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可，具备证券投资咨询业务资格。

投资评级体系与评级定义

股票投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及（或）估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法。
买入	股价表现将强于基准指数 20%以上
增持	股价表现将强于基准指数 5-20%
中性	股价表现将介于基准指数±5%之间
减持	股价表现将弱于基准指数 5%以上
行业投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及（或）估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法。
增持	行业基本面看好，相对表现优于同期基准指数
中性	行业基本面稳定，相对表现与同期基准指数持平
减持	行业基本面看淡，相对表现弱于同期基准指数

相关证券市场基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；港股市场以恒生指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准指数。

投资评级说明：

不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。

特别声明

在法律许可的情况下，甬兴证券有限公司(以下简称“本公司”)或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问以及金融产品等各种服务。因此，投资者应当考虑到本公司或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。也不应当认为本报告可以取代自己的判断。

版权声明

本报告版权属于本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用本报告中的任何内容。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。

重要声明

本报告由本公司发布，仅供本公司的客户使用，且对于接收人而言具有保密义务。本公司并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为本公司的客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐及其他交流方式等只是研究观点的简要沟通，需以本公司发布的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，本公司对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时思量各自的投资目的、财务状况以及特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。市场有风险，投资须谨慎。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司和关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，本公司可发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。投资者应当自行关注相应的更新或修改。